

证券代码：300672

证券简称：国科微

## 湖南国科微电子股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	华源证券 白宇；山西证券 高宇洋；华福证券 罗通；国信证券 张大为；财通证券 朱陈星；浙商证券 王凌涛、赵洪；平安证券 徐勇、徐碧云；华金电子 熊军；信达证券 杨宇轩；飞鸣投资 卢振（排名不分先后）。
时间	2025年9月23日 15:00-17:30
地点	湖南省长沙市长沙县榔梨街道东四路南段128号国科集成电路产业园9#栋5楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：黄然先生 证券事务代表：叶展先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、陪同投资者参观公司展厅，介绍公司基本情况、业务布局、产品研发等情况。</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、公司的AI SoC有哪些核心竞争优势？</p> <p>答：2025年，公司围绕“ALL IN AI”战略，基于自研先进MLPU技术，持续聚焦人工智能边缘计算AI SoC研发，基于大模型+SoC赋能智能终端大模型应用。</p> <p>公司AI SoC系列化产品包括8TOPS小算力AIoT终端芯片、16TOPS边缘计算芯片，以及预研的64TOPS~128TOPS大算力芯片，形成AI算力低中高的AI SoC产品布局，主要应用于AIoT智能终端、AIPC、工业计算、机器人（含具身智能）等场景应用。</p>

基于 MLPU 的创新架构设计，公司积极布局 AI 生态建设，2025 年内合作伙伴生态已覆盖国内主要的端侧大模型公司，并形成意向合作，为最终 AI SoC 系列产品上市提前布局。公司围绕大模型及其大模型产品，深度优化适配，提供从模型压缩转化、推理部署、应用开发端到端全栈大模型工具链，方便开发者和客户能够简单高效地完成模型部署和应用开发，打造更具通用性、可用性和应用性的 AI SoC 系列产品。

**2、公司在车载电子行业研发了哪些产品？产品性能如何？是否有未来规划？**

答：公司在车载 AI 芯片和 SerDes 芯片领域持续投入研发。

公司推出的车载 AI 系列芯片主要应用在前装智能摄像头、行车记录仪、流媒体电子后视镜、电子外后视镜、摄像头监控系统、驾驶员疲劳监测系统、座舱监控系统、前视 ADAS 一体机等产品上，公司 2025 年上半年推出新一代满足 AEC-Q100 Grade2 的车载 AI 芯片已回片并点亮，AEC-Q100 的相关验证正在进行中，目前在积极推广。公司将持续研发新的产品，计划三年内形成 200 万至 800 万、算力从低到高的全系列车载 AI 芯片。

同时，公司推出的串行解串（SerDes）芯片在前装车载业务领域，主要应用于智能座舱和智能驾驶的摄像头端和显示屏端的数据传输。公司在 2024 年已推出多颗 4.2Gbps 和 6.4Gbps 芯片，覆盖摄像头和显示屏业务，技术指标优秀，满足车载场景要求。

**3、公司的 Wi-Fi 产品研发进展以及产品规划？**

答：公司 Wi-Fi 业务归属于物联网业务板块，2025 年上半年，公司物联网系列芯片产品实现销售收入 12,814.71 万元，同比增长 251.37%，占公司 2025 年上半年营业收入的 17.28%。物联网系列芯片产品上半年整体毛利率为 41.07%，同比提升 26.93 个百分点。

公司确定了立足中低端、积极发展中高端，并在低中高端实现无线局域网芯片的全面国产替代的策略。目前，公司开发的 Wi-Fi6 2T2R 无线网卡芯片已开发完成并完成调试，正在导入国内主流的电视和运营商的方案厂商及网卡厂商，有部分客户已经实现小批量试产。在 Wi-Fi6 2T2R

的基础上，公司的 Wi-Fi6 1T1R+蓝牙的 Combo 芯片正在进行回片调试，目前芯片功能和性能正常，有望在 2025 年 Q4 开始客户导入。另外，公司针对 IPC、行车记录仪、图传、网卡市场开发的 Wi-Fi4 1T1R 无线局域网芯片已经量产。公司将加速在无线局域网芯片领域的研发进度，并积极开展 Wi-Fi7 芯片的预研工作。

**4、并购项目目前进展如何？标的企业处于亏损状态，是否侵害中小投资者利益？**

答：本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，本次交易所涉及的审计、评估、尽调等工作已有序开展，交易方案正在进一步协商完善中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案、披露重组报告书、并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

标的公司是国内少数可以提供覆盖 SUB 6G 全频段、全工艺滤波器的晶圆制造企业，掌握高端 BAW 滤波器制造技术。相关技术成果作为射频前端最后实现国产化的芯片技术，不仅打破了海外厂商在滤波器制造领域的工艺垄断，更有效破解了我国通信芯片行业长期依赖海外供应的问题。后续标的公司将持续导入优质客户和高端产品订单，进一步优化产品结构，逐步兑现其特色工艺线的技术优势；长期而言，随着产能稳步释放及前期购置设备的折旧期逐步结束，标的公司将实现毛利率等财务指标的显著改善，对上市公司的财务表现起到积极作用。

本次交易充分考虑中小股东利益并设置包括锁定期、减持价格、股东决策等保护机制：（1）交易对方三年内不减持其持有的上市公司股份。三年届满后，若中芯宁波实现盈利，交易对方可以依规减持其持有股份；若中芯宁波未实现盈利，则交易对方投资期限未超过十年的仍不减持，超过十年的可以减持 50%持有股份，后续待中芯宁波盈利后，方可减持剩余股份；（2）减持价格不得低于本次发行价；（3）股东会表决阶段，关联股东将根据相关法律法规严格履行回避义务，上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人将自愿回避表决，将选择权充分交给中小投资者。

附件清单（如有）	无
日期	2025 年 9 月 23 日